

はんだ・微細接合部会 シンポジウム

～生成 AI 時代のエレクトロニクス実装の最前線～

開催日：2026年7月7日（火）

開催場所：溶接会館 2階ホール及びオンライン開催

主 催

一般社団法人 日本溶接協会

企 画

はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会

協 賛

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

一般社団法人 スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会

一般社団法人 日本溶接協会 マイクロソルダーリング要員認証委員会

後 援

一般社団法人 電子情報技術産業協会

(依頼中含む)

[開催趣旨]

生成 AI の急速な発展は、エレクトロニクス機器を取り巻く環境を大きく変えつつあります。大規模モデルを支える AI サーバには高密度実装と高度な熱設計が求められ、部品実装技術そのものにも生成 AI が新たなインパクトを及ぼし始めています。こうした変化に対応し、次世代のエレクトロニクス実装技術をどう構築していくかが、実装分野に関わる産学の共通課題となっています。

本シンポジウムでは、「生成 AI 時代のエレクトロニクス実装」をメインテーマに据え、第一線でご活躍される講師陣による最新の研究開発動向をご紹介します。後半では「はんだ関連材料・機器 技術紹介」として、当はんだ・微細接合部会会員企業からの新技術・製品紹介に加え、焼結型接合材料の試験方法の国際標準化に関する話題提供を行います。

エレクトロニクス実装の「今」と「これから」を展望する場として、皆様の積極的なご参加を心よりお待ちしております。

【プログラム】

Part1:

座長：大阪大学 巽 裕章 氏

13:00-13:05 開会挨拶 はんた・微細接合部会
部会長 島村 将人 氏 千住金属工業(株)

13:05-13:55 「生成 AI の基礎知識、部品実装、生成 AI のインパクト」

太陽誘電 (株) 寶藏寺 学 氏

13:55-14:45 「生成 AI 時代の AI サーバのトレンドとその冷却」

篠原電機 (株) 犀川 真一 氏

14:45-15:00

休憩

Part2: はんた関連材料・機器 技術紹介

座長：群馬大学 小林 竜也 氏

15:00-16:00

「高密度実装や微細部品搭載に向けたソルダリング材料の紹介」

(株) タムラ製作所

「電子デバイス洗浄の課題と展望」 ゼストロンジャパン (株)

「鉛フリーはんたこて試験方法」 白光 (株)

Part3: 「半導体デバイス向け焼結型接合材料に関する国際標準化」活動報告

座長：(株)村田製作所 田北 林太郎 氏

16:00-16:50

「背景と活動概要報告」 大阪大学 西川 宏 氏

「接合せん断強度試験」 室蘭工業大学 安藤 哲也 氏

「印刷性試験・熱伝導率試験」 群馬大学 小林 竜也 氏

「機械的特性試験」 大阪大学 巽 裕章 氏

16:50-17:00 閉会挨拶

はんた・微細接合部会

技術委員長 荘司 郁夫 氏 群馬大学

・講師およびスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。

【開催要領】

1. 日 時

2026年7月7日（火）13:00～17:00

2. 場 所

日本溶接協会 溶接会館 2階ホールおよびオンライン(WEB)開催
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 及び Zoom webinar

3. 定 員（定員になり次第、締切となります）

溶接会館での参加 : 70名
オンラインでの参加 : 100名

4. 参加費

会 員 10,000円
非会員 15,000円

※上記料金は参加者1名分となります。料金にはテキスト代（PDF）・消費税を含みます。

※会員とは、日本溶接協会 本部団体会員 (<https://www.jwes.or.jp/about/membership/>)
およびマイクロ溶ダリング資格保持者です。

※協賛団体会員は、日本溶接協会会員に準拠します。

5. 申込締切日

2026年6月15日（月）（定員になり次第、締切となります）

6. 申込要領等

(1) お申込は下記 URL からお願いいたします。

<https://www-it.jwes.or.jp/seminar/>

（右記 QR コードからもお申込可能です。）



(2) 入力いただいた個人情報は「個人情報保護に関する法律」に則り当協会が定めた個人情報保護方針に従い管理します。詳細は「一般社団法人 日本溶接協会 個人情報保護方針」 (<https://www.jwes.or.jp/privacy/#info>) をご参照下さい。

(3) 参加費は以下の口座へお振込み下さい。

三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921（一社）日本溶接協会

（原則として銀行口座への振込をもって領収に代えさせていただきます。）

銀行振込手数料は各自ご負担下さい。

請求書ご希望の場合は、申込時に摘要欄にご記載下さい。

(4) お振込後の参加費は返金いたしません。ご欠席の場合は、代理出席をお願いいたします。

（シンポジウムが中止となった場合のみ費用は全額返金致します）

(5) 開催1週間前までにメールにてテキストPDFダウンロードのご案内をお送りします。

未着の場合は事務局までご連絡下さい。

※お申込みから当日までの流れ【溶接会館へお越しの方】

①受講確定メールには、【受講番号】が明記されております。受付の際受講番号で出席確認しますので、印刷またはスマートフォンでの画面をご提示下さい。

※お申込みから当日までの流れ【オンライン参加の方】

- ①受付手続完了後に当協会よりお送りする受講確定メールに【受講番号】が記載されております。下記登録の際に必要となります。
- ②オンライン事前登録完了後、オンラインシンポジウム参加用 URL をお送りいたします。
※参加用 URL はご登録者様専用のため、他の人との共有はできません。
※シンポジウム開催の 1 週間前までに事前登録用 URL がお手元に届かない場合は、事務局までご連絡下さい。
- ③オンラインシンポジウム当日、シンポジウム開始時間 15 分前までに②の URL にアクセスいただき、ご参加下さい。

※別途、詳しい手順をご案内いたします。

【注意事項】

- ◆インターネット経由でのライブ配信ですので、回線状態などにより、画像や音声がかかる場合があります。また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合がありますが、あらかじめご了承下さい。
- ◆本オンラインシンポジウムはお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止させていただきます。
- ◆本オンラインシンポジウムの配信（撮影・録音・録画・スクリーンショットの取得その他一切の手段による）および講演内容の無断転用・転載は法律に基づき、固く禁止させていただきます。
- ◆その他やむを得ない事由により、講師による講演は別会場から講演となる可能性または、シンポジウムが中止となる場合がございます。

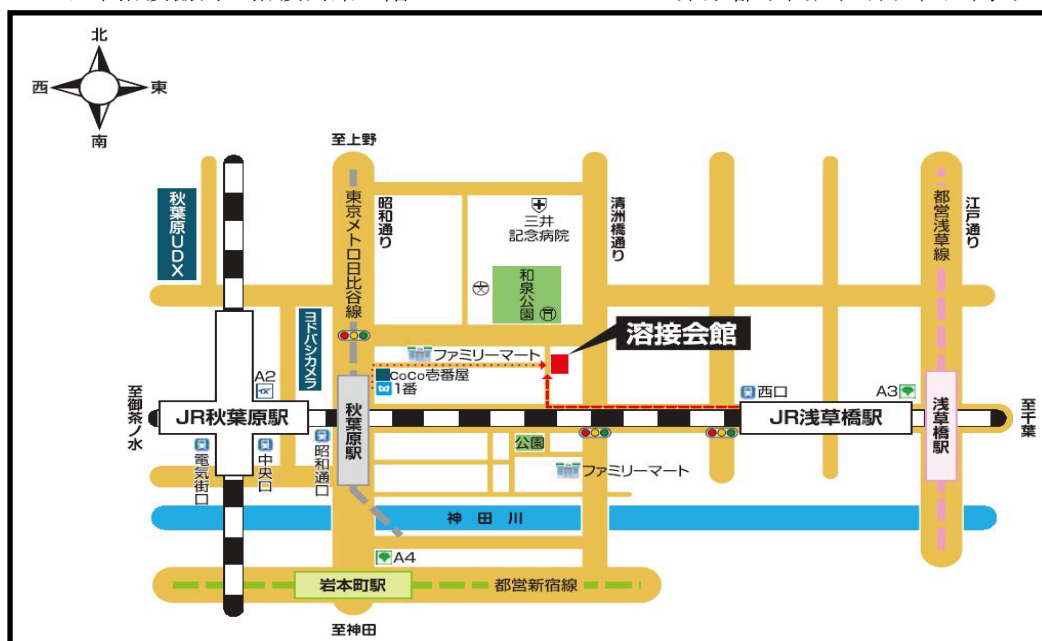
7. 事務局（連絡先）

一般社団法人日本溶接協会 業務部 今岡

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 TEL：03-5823-6324 FAX：03-5823-5244

8. 会場

日本溶接協会 溶接会館 2 階ホール 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20



【交通案内】

JR 秋葉原駅 昭和通口から徒歩 8 分 / JR 浅草橋駅 西口から徒歩 8 分

東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 1 番出口より徒歩 7 分

都営新宿線 岩本町駅 A4 出口より徒歩 12 分 / 都営浅草線 浅草橋駅 A3 出口より徒歩 11 分